

PCB加工工艺要求说明

1. 一般信息

- 1.0 主要技术联系人: 蔡雪琴 电话: 17704021259
邮箱: xueqin.cai@hanputek.com 传真:
- 1.1 其他技术联系人: 戴康明 电话: 13714646123 邮箱: kangming.dai@hanputek.com
戴康明 电话: 13714646123 邮箱: kangming.dai@hanputek.com
- 其他技术支持联系人: kangming.dai@hampoo.com
- 注意: EQ确认单问请抄送上述所有邮箱, 如一定时间内未回复, 请电话联系“主要技术联系人”, 以保证第一时间确认工程问题, 谢谢!

2. 交货信息

- 2.0 交货期: 正常周期
- 2.1 交货数量:
- 2.2 交货地址和收货人: 深圳宝安区西乡水库路116燕达科技园厂房3楼 柯勇
- 2.3 交货附件: ☒ 电测报告 ☒ 出货检测报告 ☐ 阻抗测试报告 ☒ Gerber
☒ PCB切片报告(最小直径过孔及内/外层线路位置) ☐ 其他

3. 订单信息

- 3.0 是否新订单: ☒ 新投, 提供新的文件及加工信息
☐ 只在交货信息上有所不同, 其余要求及文件不做变动
☐ 在加工要求等方面有少许修改
☐ 改版, 在原有版本的基础上有少量的改动
- 3.1 板名: CRD30DD12N_30KW_MAIN_BOARD 特殊板种类: 一般通孔板
- 3.2 层数: 4层 最小孔径(mm): 0.3048
- 3.3 基材: FR4 孔密度(个/平方米): 11266.15
- 3.4 厚径比: 7:1 最小线宽/距(mil): 6.00/10.00
翘曲度: $\leq 0.75\%$
- 3.5 单板(Unit)尺寸(mm): 304.00 X 273.00 拼板方式: 1 X 1
拼板(Set)尺寸(mm): 每拼板(Set)单板(Unit)数: 1 组成拼板的单板种数: 1
☐ V-CUT:
- 3.6 板厚(mm): 2 公差: $\pm 10\%$
- 3.7 阻焊: 双面印 颜色: 绿色 阻焊光面: 亮光
- 3.8 字符: 双面印 颜色: 白色
标记: ☒ UL 标记所在层: Silk Top
请不要在板内空白区域添加制板厂logo.
请在板内空白区域添加板子生产日期.
- 3.9 表面处理: 无铅喷锡 锡厚: 1-40um 镀金手指: ☒ 无 ☐ 有, 金厚:
金手指斜边: ☐ Yes ☒ No
板厚削薄边: ☐ Yes ☒ No
- 3.10 过孔阻焊处理方式: ☒ 除焊盘区域外整板塞孔 ☐ BGA区域塞孔, 其他按Gerber
☐ 整板过孔塞孔 ☐ 全部按Gerber 塞孔物质: 油墨
- 3.11 阻抗控制: ☐ Yes ☒ No
- 3.12 盲孔/HDI: ☐ Yes ☒ No
- 3.13 验收标准或规范: ☒ IPC-6012-II, current revision.
- 3.14 IPC网表对比: ☒ Yes ☐ No
- 3.15 回传GERBER: ☒ Yes ☐ No
- 3.16 回传钢网文件: ☒ Yes ☐ No
- 3.17 包装要求: ☒ 真空包装 ☒ 板间隔纸
☒ 中性包装纸箱(无加工厂LOGO) ☐ 其它:
- 3.18 附件: 图纸 无 其他文件:
- 3.19 其他要求:

- 1) 请工程尽快审核资料并及时提出问题（2--5小时为佳），当加工工艺说明书与光绘文件不符时请与工程师确认；
- 2) 我司所有单都必须回传光绘及钢网文件，工程制作完成后，请及时回传文件至kangming.dai@hampoo.com存档，所有工程问题及更改也需要抄送至此邮箱。

4. 叠层设置

